



**한미반도체**

**기업가치 제고 계획**

2025년 6월

# Disclaimer

본 자료는 한미반도체 주주 및 투자자 등 이해관계자 정보 제공 목적으로 작성되었습니다. 본 자료에 기재된 내용 중에는 회계감사 처리되지 않은 재무정보가 포함되어 있습니다. 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

회사는 자료의 내용 완결성에 대해서 어떠한 진술 보장도 하지 않습니다. 또한, 당사의 사전 동의 없이 본 문서의 내용을 수정, 배포 및 복제할 수 없습니다.

본 자료는 한미반도체의 계획 및 이용 가능한 정보를 바탕으로 한 확정되지 않은 미래 재무 실적, 사업전망 등 예측 정보를 포함하고 있습니다. 향후 경영여건과 시장상황 변화에 따라 실제 결과는 달라질 수 있으며, 계획 사항은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

본 자료에 기재된 정보는 별도의 통지 없이 변경될 수 있으며, 제공 당시의 상황에 따라 해석되어야 합니다. 또한, 회사는 본 자료 제공 이후의 중대한 변화를 반영하도록 업데이트할 의무를 부담하지 않습니다.

본 자료는 투자자들의 투자 결과에 대하여 어떠한 법적인 목적으로 사용되어서는 안되며 당사는 본 자료 또는 본 자료에 포함된 정보를 이용함으로써 인해 발생하거나 기타 본 자료와 관련하여 발생하는 손해에 대해서 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.

# • 한미반도체 이익소각 이행내역

- 당사는 **최근 8년간, 총 7번의 이익소각**을 진행하며 주주가치 제고를 위해 힘쓰고 있습니다.

## 이익소각 이력

날짜	주식 수	소각 금액
<b>2025.05.19</b>	<b>1,302,059</b>	<b>1,302.8억원</b>
2024.10.25	379,375	372.5억원
2024.04.18	345,668	200.0억원
2022.11.14	1,580,452	200.0억원
2021.03.05	2,041,624	165.1억원
2020.01.22	5,722,389	399.9억원
2018.07.02	6,358,210	361.1억원
<b>합계</b>	<b>17,729,777</b>	<b>3,001.4억원</b>

당사는 2025년 2월 13일 **자사주 소각 진행** 계획을 공시를 통해 밝혔으며, 5월 29일 소각 진행 후, 6월 18일 **변경상장 완료**했습니다.



최근 8년 간  
총 7회 이익소각 진행  
—  
총 3,000억원 규모

## • 글로벌 AI 반도체 시장 상황 대응

- AI반도체 시장의 성장세와 함께 향후 5년 내 HBM 수요 지속 증가
- 글로벌 반도체 기업들의 공격적인 CAPA 확장에 따른 해외 고객사 대응 강화

01

**GPU 개별 로드맵 강화**  
(엔비디아 · 브로드컴)

02

**Custom Chip 수요 증가**  
(아마존 · 구글 · MS)

03

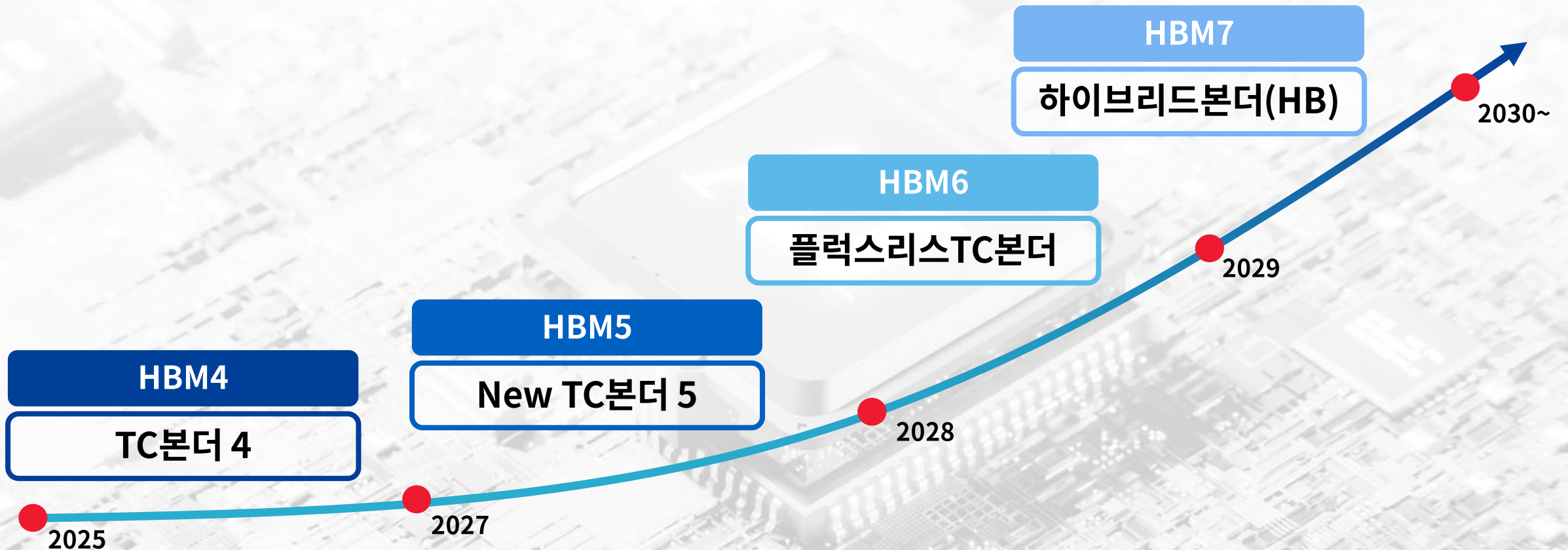
**Sovereign(소버린)**  
**AI 수요 증가**  
(중동국가)

04

**미국 상무부 2035년까지**  
**55단 HBM 로드맵 제시**

## • 한미반도체 HBM TC본더 로드맵

- 2025년 4월 16일, JEDEC(국제반도체표준협의기구)에서 HBM4 표준 규격을 완화(720 $\mu$ m → 775 $\mu$ m)
- 첨단 하이브리드본더(HB) 활용하여 20단 이상 프리미엄 HBM 생산 + 전용 시스템 반도체(ASIC칩) 생산 계획
- 높은 정밀도와 뛰어난 생산성을 바탕으로 글로벌 No.1 TC본더 메이커로 입지 강화 → 글로벌 HBM 메이커 수요에 대응



## • 한미반도체 CAPA 확장 플랜

- 건설 중인 7공장을 **하이브리드본더(HB)** 전용 공장으로 활용할 예정입니다.

